



## Tagesordnung

Thema: 60. Treffen des Arbeitskreises  
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und  
Verbindungstechnologien“

Datum: **Montag, 15. Mai 2017, 10.00 Uhr**

Ort: Messezentrum Nürnberg, **NCC-Ost**, Saal Oslo

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
Reinheitszuverlässigkeitsanalyse  
*Herr Dr. Schweigart, Zestron, Ingolstadt*
- 3 10:50 Uhr  
Prozesse für zuverlässige Verbindungen  
*Herr Fehrenbach, Eutect GmbH, Dusslingen*
- 4 11:30 Uhr  
Leiterplatten für Automotiv-Sensorsysteme  
*Herr Georgiev, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf*
- 5 12:10 Uhr  
Mittagessen

- 6 13:10 Uhr  
Beschleunigte Lebensdauertests in der Kfz-Elektronik  
*Herr Fella, Conti Temic microelectronic GmbH, Nürnberg*
- 7 13:50 Uhr  
Organische und gedruckte Elektronik im Alltag  
*Herr Dr. Hecker, OE-A, Frankfurt*
- 8 14:30 Uhr  
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr  
Oberflächenveredlung bei Elektrokomponenten  
*Herr Körbulak, Hatko Electronics, Istanbul (TR)*
- 10 15:40 Uhr  
Werkzeuge zur Bestimmung der Lebensdauer von  
Mikrosystem-Produkten  
*Herr Dr. Wagner, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 11 16:20 Uhr  
Abschlussdiskussion  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**